

先端半導体のプロセスを支える加工技術の最前線

AI や EV の普及に伴う半導体の微細化・3D 実装化、次世代パワー半導体の台頭など、ウェハにはナノメートル規模の平坦度と極限の清浄度が求められています。本講演では、市場の最新動向を概説いただくとともに、歩留まり向上に直結するエッジ加工、ウェハ形状の基礎となる高精度研磨機、各種材料の平坦化を支える CMP・精密洗浄技術について、第一線で活躍する 4 名の講師をお招きし、それぞれの専門領域における最新技術と将来展望について解説いただきます。

主 催：公益社団法人 砥粒加工学会 次世代固定砥粒加工プロセス専門委員会

日 時：2026 年 12 月 18 日(金) 13:00～17:00

開催方式：下記会場（対面）と Cisco Webex Meeting

（Web）のハイブリッド形式で開催します。

会 場：日本大学 理工学部 駿河台キャンパス

1 号館 6 F CST ホール

〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台 1-8-14

当日連絡先：03-3259-0404

<https://www.cst.nihon-u.ac.jp/campus/surugadai/>

※ Web 開催に関する詳細情報は、参加ご希望の方に後日通知いたします。



13:00～13:05	開会挨拶	委員長 日本大学 山田 高三 氏
13:05～14:05	講演1 「半導体産業の利益率はどうして高いのか？ 自動車産業と比較してみる」	株式会社レゾナック 近藤 誠一 氏
14:05～14:55	講演2 「先端半導体基板のエッジ加工技術」	マイボックス株式会社 大橋 達也 氏
14:55～15:05	<休 憩>	
15:05～15:55	講演3 「先端半導体のプロセスを支える加工技術－研磨加工技術の最前線－」	浜井産業株式会社 杉下 寛 氏
15:55～16:55	講演4 「半導体 CMP・精密洗浄のサイエンス化とイノベーション創出の方法論」	株式会社フジインコーポレーテッド 森永 均 氏
16:55～17:00	閉会挨拶・事務連絡	
17:10～19:10	技術交流会（同じ会場の2階カフェテリア 予定）	

司会：加藤 智久（産業技術総合研究所）、河田 研治（K-Labo）、伊東 利洋（クレザス株式会社）

参加費：研究会：当専門委員会会員：無料、非会員：15,400 円（税抜額 14,000 円＋消費税 1,400 円）、非会員アカデミア：6,600 円（税抜額 6,000 円＋消費税 600 円）、学生：無料

※会員は 5 人／社まで、非会員は 2 人／社まで研究会に参加できます。

技術交流会：会員資格に関わらず 2 名／社まで参加できます。3 人目からは 4,950 円／人（税抜額 4,500 円＋消費税 450 円）を徴収します。

（注）「会員」とは専門委員会会員を指します。学会員ではございませんのでご注意ください。

（注）価格は消費税 10%を含みます。

申込締切日：2026 年 12 月 3 日(木)

（注）当日キャンセルの非会員には、すでに準備に費用がかかっているため参加費を請求致します。

問合せ/申込先：次世代固定砥粒加工プロセス専門委員会事務局

・ E-mail：sf-staff@jsat.or.jp

・ 申し込みはホームページよりお願いいたします。→<https://jsat-sf.jp/event.html>